

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-35

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	招商证券、西南证券、中泰证券、方正证券、华安证券、T. Rowe Price、德邦证券资管、冠达泰泽
时间	2023年11月17日
地点	深南电路股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事中高端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控医疗等领域。下游应用分布情况较今年上半年未发生重大变化。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023年前三季度，通信市场整体需求未明显改善。在市场环境带来的挑战下，公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，并持续加大力度推进新客户开发工作；此外，公司也将继续关注和研究行业技术演进趋势，根据行业需求做好相应技术储备。</p> <p>Q3、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。</p> <p>数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡</p>

献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023 年前三季度，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第三季度，数据中心领域下游部分客户项目订单有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023 年前三季度，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占 PCB 整体营收比重有所提升。

Q5、请介绍公司封装基板业务在下游市场拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年第三季度，受消费电子等下游市场需求局部修复影响，公司各类封装基板订单环比有所增长。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果。同时，公司在 FC-BGA 封装基板的技术研发与客户认证工作均按期有序推进。

Q6、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。

相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。公司无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，目前产能利用率达到四成。

	<p>Q7、请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。</p> <p>Q8、请介绍公司广州封装基板项目的建设连线进展。</p> <p>公司广州封装基板项目主要面向 FC-BGA 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板三类产品。项目共分两期建设，其中项目一期已于 2023 年 10 月下旬连线，目前处于产线初步调试过程中，后续将逐步进入产能爬坡阶段。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 17 日